

USB3.1C S1H DN1 RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	OMNIMATE Data - gniazdo USB, Gniazda USB, 10 Gb/s, Przyłącze lutowane SMD, 90°, ≥ 10000, Raster w mm (P): 0.50 mm, Liczba biegunów: 24, LCP, czarny, Szpula
Nr zam.	2987560000
Typ	USB3.1C S1H DN1 RL
GTIN (EAN)	4099986855052
Ilość	1 050 Szt.
opakowanie	Szpula

Data sporządzenia 6 czerwca 2024 13:44:20 CEST

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	7,9 mm	Głębokość (cale)	0,311 inch
Wysokość	3,21 mm	Wysokość (cale)	0,126 inch
Szerokość	8,94 mm	Szerokość (cale)	0,352 inch
Masa netto	10 g		

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	750 V AC
napięcie znamionowe	5 V		

Specyfikacje systemu

Cykle wpinania	≥ 10000	Długość kołka lutowniczego (l)	1,15 mm
Ekranowanie	360° styk ekranowany	Klasa mocy	10 Gb/s
Liczba biegunów	24	Materiał ekranu	mosiądz
Powierzchnia ekranu	niklowany	Proces lutowania	Lutowanie rozpliwowe, Lutowanie ręczny
Raster w calach (P)	0,02 "	Raster w mm (P)	0,5 mm
Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazdo USB	Stopień ochrony	IP20
Szybkość przesyłania danych	10 Gb/s	Zaciski ekranu	brak
kąt odejścia	90°	liczba kołków lutowanych na biegun	1
montaż na płytce drukowanej	Przyłącze lutowane SMD	zamknięcie boczne, właściwość	Brak

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	LCP	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Wytrzymałość izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Moisture Level (MSL)	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
podstawowy materiał styku	stop miedzi	Materiał styków	Złoto na niklu
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	80 °C		

Opakowanie

opakowanie	Szpula	Długość VPE	0
Szerokość VPE	0	Wysokość VPE	0

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01		

Pobieranie

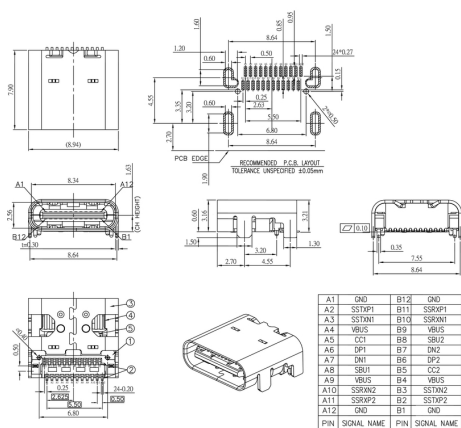
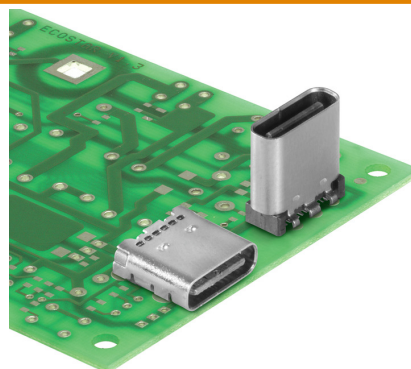
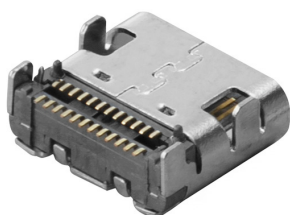
Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.